

MIRS 不具合報告書

1班 報告者 野村柚衣子 発見日 平成 30 年 5 月 25 日 完了日 平成 30 年 5 月 25 日

不具合件名	要因分析
回路の半田付け不良	テスターを使って導通チェックをすると、基板の半田とスズメッキ線がつながっていなかった。
不具合の概要	図 1 に半田付け部分の写真を示す。
Arduino のシールド基板の半田付けがしっかりとできていないところがあった。 この不具合は、統合試験の際に見つけた。	
考えられる要因	図 1 半田付け部分
<input type="checkbox"/> 半田付けの際の基板をしっかりと温めていないことによる半田付け不良で、断線してしまっている	
	不具合箇所の別 (エレキ) および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	半田付けをし直して、直した。 また、半田付けの際にしっかりと基板を温めてから半田を流すように心がける。